東海大學研發成果專利申請表

（專利申請表1）

申請日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 專利申請 名稱 | 中文 |  | | | | |
| 英文 |  | | | | |
| 1. 發明人代表 | 姓名 |  | | 聯絡電話 |  | |
| 單位/職稱 |  | | E-mail |  | |
| 1. 聯絡人 | 姓名 |  | | 聯絡電話 |  | |
| 單位/職稱 |  | | E-mail |  | |
| 1. 智慧財產權 歸屬 | □本校  □共有（請填寫下列共有單位名稱及成果歸屬比例）  本校【 %】、共有單位 【 %】  註：請檢附共有合約書  □其他（請說明）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  註：請勿以個人名義持有專利，若因特殊狀況(如因應專利申請國之要求)，以個人名義申請專利者請說明，並由研發成果管理委員會審議之，後續應填具「東海大學專利權讓與申請表」主動讓與本校。 | | | | | |
| 1. 本研發成果來源   （計畫主持人須為發明人代表） | □國科會　□農業部　□經濟部　□其他補助機關：  □一般產學合作計畫　□本校教師職務成果（勾選本項者，免填下列欄位） | | | | | |
| 計畫編號： 校內計畫序號：  計畫名稱： | | | | | |
| 1. 申請國家及 類型 | □中華民國　□美國　□日本  □其他國家：  理由： | | | | | |
| □發明專利　 □新型專利 □設計專利 | | | | | |
| 1. 公開揭露 紀錄 | 是否已公開？  □是　　　　　　　　□否，但未來會公開  □否，未來亦無公開之計畫（勾選本項者，下列公開資料免填） | | | | | |
| 已（或預計）公開之方式及日期：  □學位論文：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （口試日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；繳交日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日）  □國內外期刊：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （投稿日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；(預計)出版日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日）  □技術公開演說：發表日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  （活動型式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，例如：新聞、海報、口頭、書面等）  □計畫結案報告日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  註：揭露本項資訊者，請檢附已發表之期刊、論文……等（如為外文，須附中譯本）。 | | | | | |
| 1. 檢附資料 | □專利申請表（表1）  □專利申請費用分攤暨權益收入分配協議書（表2）  □專利申請說明書（表3）  □計畫經費核定清單或計畫合約書影本。  □本申請案之電子檔請E-mail至產學與育成中心[iic@thu.edu.tw](file:///D:\1.★智慧財產權\1.★專利\1.★本校資料(含申請表格、委員會、申請案件資料)\1.法規及申請表格\2.專利相關表單\1.申請\iic@thu.edu.tw)。  □其他（如已發表論文等）： 。 | | | | | |
| 申請單位 | | | | | | 研發處 |
| 發明人代表簽章 | 單位主管 | | 一級主管 | | | 一級主管 |

＊東海大學（以下簡稱本校）為雙方業務合作聯繫之目的，須蒐集辦理專利申請事宜所需之姓名、職稱、住址、行動電話、電子郵遞地址、金融機構帳戶之號碼與姓名、身分證統一編號、年齡、性別、出生年月日等個人資料(辨識類：C001辨識個人者、C002辨識財務者、C003政府資料中之辨識者；特徵類：C011個人描述)，以在雙方合作關係存續期間及地區內進行必要之聯繫。

＊本校於蒐集您的個人資料時，如有欄位未確實填寫，則可能對雙方之合作聯繫有所影響。如欲更改個人資料或行使其他個人資料保護法第3條的當事人權利，請洽本校產學與育成中心。

東海大學研發成果  
專利申請費用分攤暨權益收入分配協議書

（專利申請表2）

（適用權利為【共有】）

一、專利名稱： 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 。

二、申請國別： 　　　　　　　　　　 。

三、本校與**本校所屬發明人**專利費用分攤及權益收入分配，將依本校「研究發展成果管理辦法」及本協議書辦理。

（一）**專利費用分攤比率**及**收益分配比率**說明：

扣除資助機關補助金額後，專利申請費用（如專利申請之申請費、證書費、第一期專利年費、事務所手續費及其他依法令應繳納之專利規費等）之負擔比率得由本校人員之發明人依下列方案自行選擇其中之一，並經研發成果管理委員會決議之。此五種方案之選擇將影響研發成果收益之分配比率。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 專利費用分攤 方案 | 專利申請費用分攤（%） | | 收益分配比率（%） | |
| 本校 | 發明人 | 本校 | 發明人 |
| **一** | 100 | **0** | 75 | **25** |
| **二** | 85 | **15** | 55 | **45** |
| **三** | 70 | **30** | 40 | **60** |
| **四** | 55 | **45** | 25 | **75** |
| **五** | 0 | **100** | 15 | **85** |

（二）本案經本校所屬發明人一致同意選擇第 方案為與學校之專利費用分攤比例。

（三）本專利之專利申請費用分攤「發明人」部分**費用分攤與繳款**方式（不含共有單位）：

□ 統一由本校發明人代表統籌處理。（若勾選本項，下方欄位免填）

□ 由產學與育成中心協助以下列比例拆分專利費用，惟請本校發明人代表協助聯繫：

| 序號 | 本校所屬發明人姓名 | 費用拆分比例 | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （發明人代表） | % |  |
| 2 |  | % |  |
| 3 |  | % |  |
| 本校發明人小計 | | 100% |  |

四、若發明人為二人（含）以上，請自行協調並於下表填寫貢獻比例、權益收入分配比例。日後有關發明人權益收入分配，將依此原則辦理之。

| 屬本校之發明人 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 姓名 | 貢獻比例 | 權益收入分配比例 | 備註 |
| 1 | （發明人代表） | % | % | 多位發明人時請自行增列欄位 |
| 2 |  | % | % |  |
| 3 |  | % | % |  |
| 小計 | | % | 100% | **權益收入分配比例係指分配予本校發明人部分，不包含共有單位分配部分** |
| 屬共有單位之發明人 | | | | |
| 序號 | 姓名 | 貢獻比例 | 權益收入分配比例 | 備註 |
| 4 |  | % | 由共有單位自行辦理，無須填寫 |  |
| 5 |  | % |
| 6 |  | % |
| 小計 | | % |
| 合 計 | | 100 % | 100% | **全部發明人（含共有單位）之貢獻比例合計應為100%** |

**註：權益收入分配比例於全體發明人同意下，可依實際技轉情形重新調整。**

五、所有發明人一致同意上表發明人協議之與學校之專利費用分攤比例、貢獻比例、費用分攤方式及權益收入分配比例等內容：

1. 發明人：　　　　　　　　　　（簽章） 日期：　 　年　　月　　日
2. 發明人：　　　　　　　　　　（簽章） 日期：　 　年　　月　　日
3. 發明人：　　　　　　　　　　（簽章） 日期：　 　年　　月　　日
4. 發明人：　　　　　　　　　　（簽章） 日期：　 　年　　月　　日
5. 發明人：　　　　　　　　　　（簽章） 日期：　 　年　　月　　日
6. 發明人：　　　　　　　　　　（簽章） 日期：　 　年　　月　　日

東海大學研發成果專利申請說明書

（專利申請表3）

一、發明人資料**（必填）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本案發明人共 位 | | | | |
| 1 | 姓名 |  | 英文姓名 |  |
| 身分證字號 |  | 國籍 |  |
| 服務單位 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| E-mail |  | | |
| 戶籍地址 |  | | |
| 2 | 姓名 |  | 英文姓名 |  |
| 身分證字號 |  | 國籍 |  |
| 服務單位 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| E-mail |  | | |
| 戶籍地址 |  | | |
| 3 | 姓名 |  | 英文姓名 |  |
| 身分證字號 |  | 國籍 |  |
| 服務單位 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| E-mail |  | | |
| 戶籍地址 |  | | |

註1：發明人如超過3人，不敷使用時請自行增加欄位。

註2：發明人若非中華民國國籍，身分證字號請填「居留證號碼」。

二、專利資料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） 有關此發明 最早的紀錄 | 日期 | |  |
| 公開  資訊 | |  |
| （二） 相關先前技術 調查情形 | 1. 已檢索之專利資料庫（Database） 2. 已檢索之關鍵字（Keyword）   中文：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  英文：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. 相類似技術或已經發表之文獻 | | |
| （三）  研發領域  （請先選大類，再選細項，**可複選**）  **（必填）** | □資通 電控 | □資訊工程　□電信工程　□電腦通訊　□微電子工程　　□網路科技　□光電工程　□電力工程　□自動化控制 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| □工程 科技 | □機械工程　□土木工程　□水利工程　□材料工程 □環境工程　□醫學工程　□奈米科技　□微流體晶片 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| □生物 科技 | □基因工程　□生醫檢測　□生物藥學　□生物晶片 □微生物　　□動物疫苗　□資電晶片　□蛋白質工程 □保健食品　□農業技術　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| □材料 化工 | □藥物化學　□材料化學　□光電材料　□化妝品化學　 □分析化學　□生醫材料　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| □管理 | □資訊系統管理　□工業管理　□電信管理 □企業管理模式　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| □其他 | □生活應用　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| （四）  本技術 創作目的  **（必填）** |  | | |
| （五）  技術摘要  **（必填）**    （簡述本技術的特徵，並說明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途，以200字左右為宜） |  | | |
| （六）  本發明之特色  **（必填）**  （以至少一個最佳實施例說明本發明之技術與特徵） | * 1. 既有技術之比較   2. 本發明之特點 | | |
| （七）  發明或 創作說明  **（必填）**  （應載明有關之先前技術，發明或創作之目的、技術內容、特點、功效及圖示說明，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施） |  | | |
| （八）  申請專利範圍  **（必填）**  （即claims，應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵；亦即應指定申請專利之標的名稱，並敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。） |  | | |
| （九）  圖示  **（必填）** |  | | |

三、技術推廣

|  |  |
| --- | --- |
| （一）  技術成熟度 | □量產階段　　　□試量產階段　　□雛型階段  □實驗室階段　　□概念階段　　　□其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| （二）  產業應用性  **（必填）**  （請詳細列舉此技術可能應用的產業、可運用本技術之產品、方式等） | 1. 產業利用性說明 2. 是否正在（或將要）進行相關產學合作或技術授權 |
| （三）  適用產業類別  **（必填）** | □積體電路產業　□電腦及週邊產業 □通訊產業　　 □光電產業  □精密機械產業　□運輸工具產業　 □機械設備製造 □製藥工業  □化學製品製造業□化學材料製造業　□石油及煤製品製造業  □橡膠製品製造業□農藥工業　　　□生物技術產業　□食品製造業  □電子產業 　□金屬製品製造業□非金屬製品製造業　□紡織業　　 □印刷電路板　　□出版業　　　　□營建業　　　　 □環境檢測　 □諮詢顧問業　　□其他：＿＿＿＿＿＿＿ |
| （四）  技術承接單位 應具備條件之建議 | 1. 潛在廠商：   （1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. 廠商應具備之專門技術： 2. 廠商應有設備： |